



# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 93—2015  
代替 YS/T 1993—1996

---

## 膏状软钎料规范

Paste soft solder specification

2015-04-30 发布

2015-10-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 YS/T 93—1996《膏状软钎料规范》。本标准与 YS/T 93—1996 相比,主要有如下变动:

——增加了 S-Sn99.0Ag0.3Cu0.7、S-Sn95.0Sb5.0 等两个无铅钎料牌号;

——增加了 S-In52.0Sn48.0、S-In97.0Ag3.0 钢基钎料牌号;

——增加了 S-Au80.0Sn20.0、S-Au88.0Ge12.0 低温贵金属钎料牌号。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位:贵研铂业股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准起草人:许昆、向磊、李伟、朱武勋、罗锡明、刘毅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YS/T 93—1996。

# 膏状软钎料规范

## 1 范围

本规范规定了膏状软钎料(简称焊膏)的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)等内容。

本规范适用于熔化温度低于 427 °C 的膏状软钎料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1480 金属粉末粒度组成的测定干筛分法

GB/T 3260(所有部分) 锡化学分析方法

GB /T 10574(所有部分) 锡铅焊料化学分析方法

GB /T 15072(所有部分) 贵金属合金化学分析方法

GB/T 15829 软钎剂分类与性能要求

GJB 950A(所有部分) 贵金属及其合金微量元素分析方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**焊膏** **paste solder**

由软钎焊粉末和钎焊剂调制而成的均匀混合物。

### 3.2

**活性剂** **acticator**

为改善焊接效果的钎焊剂组分之一。

### 3.3

**润湿性** **wetting**

熔融的钎料在基体(母材)表面的铺展程度。

### 3.4

**无铅标志** **Lead-free sign**

用于标明无铅焊膏的标志,标明符号如下:



[IPC/JEDEC J-STD-609,4.2]